**热常数分析仪技术指标：**

（1）\*一次测试可同时得到被测样品导热系数、热扩散系数和比热容三个数据；

（2）\*内置电桥电路，并配置精度达 6 位半的高精度万用表，可测最小电压至 0.1 uV，最小直流电流至 10 nA；

（3）\*导热系数测量范围：0.005-1800 W/(m·K)；

（4）热扩散率测量范围：0.01-1200 mm² /S；

（5）比热测量范围：0.01-5 MJ/(m³K)；

（6）\*导热系数测量精度：±3%；

（7）热扩散率测量精度：±5%；

（8）\*比热测量精度：±3%；

（9）导热系数测量重复性优于 1%；

（10）\*具有结构探头功能，能够一次测试即给出沿块体材料厚

度方向的导热系数梯度变化曲线；

（11）\*具有 1 维测试功能，能够精确测得直径 6 mm，高度

40 mm 黄铜柱的导热系数；

（12）测试环境：室温，避免任何有可能影响测量的热源如气

流，阳光直射；

（13）测试时间：1-2560 s；

（14）能够原位测试，不需制样或制样工作很少；

（15）最小样品尺寸：厚度 2 mm, 直径 10 mm，同时能够对

厚度在 100 um 高导薄片材料进行测试；

（16）工作电压：220 V，50 Hz；

（17）可测样品类型：固体、粉末、液体、片材、板材、膏状

物、各向异性和复合材料等材料。

(18) \*探头：探头：双螺旋圆形聚酰亚胺覆膜探头，主要元件为光刻镍丝，不接受覆膜为铝制涂层或玻璃材质的探头，耐-196到200摄氏度；

（19）计算机：处理器类型i5以上；内存：8GB以上；硬盘：500GB以上; Windows下安装专业分析软件包－包含数据实时采集与记录软件、数据处理与相关参数在测试过程变化曲线绘制，导热系数、热扩散系数和比热直接显示等各项功能。

（20）仪器配套控制与数据分析软件应尽量为中文版本。

（21）整机保修一年，产品终身服务

（22）应包含安装、调试，培训方案

（23）在24小时内响应用户投诉，48小时内提出解决方案